

10月29日(木) 14:00-16:40

セッションチェアマン： 山本 浩之(マイクロンメモリ ジャパン(株))・廣田 良浩(ワイドヴィル)

◆ 「半導体デバイスの最先端」とは何か？ 微細化・3D 化の歴史から考える



広島大学
半導体産業技術研究所
特命教授
青砥 なほみ

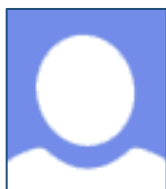
[講演要旨]

「半導体デバイスの最先端」というとロジック半導体のゲート長○○nm を思い浮かべる人は多いだろう。その○○の数字が小さいことは最先端の要素の一つだが、寸法以外にもデバイス特性など重要な指標は多くある。一方、たとえ寸法に着目しても最先端は水平方向の寸法だけでは表せない。これら誰もが知っていることを改めて微細化の切り口で整理し、半導体の挑戦がどこにあるかを皆さんとともに再認識したい。

[講演者プロフィール]

1983 年から 40 年間、半導体デバイスメーカーでプロセスを開発。業界再編により所属が NEC、エルピーダメモリ、マイクロンと変わる中、技術者から管理者として日米で開発を牽引した。2023 年より現職にて、若い人々に半導体や製造業の魅力を伝えることを使命とする。

◆ 半導体市場と技術の動向最前線(仮題)



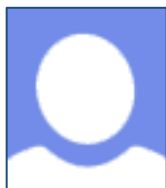
株式会社 SUMCO

小森 孝行

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ AI 時代の半導体業界を読む(仮題)



株式会社 SBI 証券
シニアアナリスト
和田木 哲哉

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【C-2】AI 時代の半導体最前線を探る

【C-3】装置・プロセス・実装技術が AI 最前線を支える